



联络人

投资人关系

+886 3397 5999 ext. 1204

ir@winfoundry.com

稳懋半导体公告 2020 年第三季自结财务报告

2020 年 10 月 28 日

稳懋半导体，全球最大砷化镓晶圆代工服务公司，已于今(28)日公告 2020 年第三季自结财务报告。

2020 年第三季财务概况

- ◆ 本季合并营收新台币 65.66 亿元，较前季增加 9%，较去年同期增加 3%
- ◆ 本季合并毛利率为 43.4%，较前季减少 1.4 个百分点；本季营业净利率 32.7%，较前季减少 0.9 个百分点
- ◆ 本季营业净利为新台币 21.46 亿元，较前季增加 6%，较去年同期增加 7%
- ◆ 本季税后净利为新台币 19.67 亿元，为历史单季新高，较前季增加 19%，较去年同期增加 20%；每股盈余为新台币 4.68 元，同创单季历史新高，前一季为新台币 3.94 元

2020 年第四季展望

下列对于未来展望的表述是基于对现况的预期，但同时受限于已知或未知风险或不确定性的影响。请参阅后附之「免责声明」。

- ◆ 预计第四季营收将较前一季成长 low-single digit 百分比。
- ◆ 第四季因产品组合变化，毛利率预计降至约 high-thirties 的水平。

免责声明

本数据可能包含对于未来展望的表述。该类表述是基于对现况的预期，但同时受限于已知或未知风险或不确定性的影响。因此实际结果将可能明显不同于表述内容。除法令要求外，公司并无义务因应新信息的产生或未来事件的发生主动更新对未来展望的表述。

管理者评论

“2020年第三季在全球依旧严峻的新冠肺炎疫情及不断升高的中美贸易冲突中落幕，虽然市场仍充满不确定性，但稳懋的营收及获利仍有不错的表现，第三季营收较前一季成长9%，优于原先的预期，累计前三季营收达新台币187亿元，较去年同期年增率达29%。虽然产能利用率随着新产能逐月开出而下滑，在产品组合优化下，单季毛利率达43.4%，与原先预期相去不远。第三季税后净利及净利率都同时登上稳懋单季历史高点，分别为新台币19.67亿元及30%，除了新台币4.68元的EPS创下历年单季之最，累积前三季EPS新台币12.38元也已超越去年全年的水平。

稳懋始终秉持着客户分散、维持研发能量及持续扩充产能的长期策略，今年5,000片的产能扩充计划已于第三季底完成上线，目前单月产能已达41,000片，是全球产能最大的砷化镓晶圆制造公司。着眼于未来几年5G网络逐渐成熟，5G手机渗透率逐年上升将进一步带动5G PA的需求提升，同时随着全球顶尖智能型手机业者继脸部辨识之后进一步导入3D感测技术于AR应用上，预期将可带动另一波风潮，也让稳懋对于未来化合物半导体代工需求持续抱持乐观期待。为满足客户的长期需求，稳懋甫于8月中获得行政院科技部核准，即将进驻南部科学园区高雄园区投资设厂，可望为成立刚满20年的稳懋奠定下一个20年的基础。

展望第四季，我们预计营收将较上一季成长 low-single digit 百分比；因产品组合变化，毛利率预计降至约 high-thirties 的水平。”

关于稳懋半导体

稳懋半导体成立于 1999 年，位于林口华亚科技园区，是全球首座以六英寸晶圆生产砷化镓微波集成电路(GaAs MMIC)的专业晶圆代工服务公司。稳懋拥有完整的技术团队及最先进的砷化镓微波晶体管及集成电路制造技术及生产设备，客户群除了全球射频集成电路设计公司(RFIC Design Houses)外，并致力吸引与全球整合组件制造(IDM)大厂合作。在制程技术发展方面，稳懋以多元化及领先为原则，期能提供客户最完整的服务。在无线宽带通讯的微波高科技领域中，稳懋目前提供两大类砷化镓晶体管制程技术：异质接面双极性晶体管(HBT)和应变式异质接面高迁移率晶体管(pHEMT)，二者均为最尖端的制程技术。在光通讯及 3D 感测领域中，稳懋更以 MMIC 生产技术为基础，提供光电产品的开发与生产制造。